2014 台灣熱管理協會年會暨技術成果發表會

◆活動宗旨：

過去二年由於全球平板電腦及智慧手機市場快速成長，使傳統 PC 產業受到嚴重衝擊而呈現負成長現象，連帶影響到國內散熱產業相關廠商之營收，但也幾家廠商積極轉型朝向非 PC 領域尋求新契機而逆勢成長，如伺服器、通訊機房及 LED 等皆是國內散熱產業開發成功的新領域；除此之外，隨著各種電子行動裝置功能的提升，耗用功率也隨之急速增加，因而出現新的散熱需求，自 2013 年下半年起，汽車及手機市場明顯成為散熱廠商鎖定的新利基市場，其中尤以手機市場的爆發力最受相關業界的矚目。因此，縱觀國內散熱產業發展，雖然近年受到平板電腦及智慧型手機市場快速成長之侵蝕而使 NB 及 DT 出貨量呈衰退現象，但在新領域之輕薄型行動通信裝置、雲端及功率模組等市場上正在創造新的商機。

台灣熱管理協會過去一年在所有會員的支持下除持續收集國內外市場的資訊與脈動外，並繼續推動各項技術交流、熱管理技術研討會及熱性能量測標準之制定，同時參與一年一度的 IMPACT 國際構裝暨電路研討會及台灣印刷電路板(TPCA)展覽，讓國內熱管理相關產學研界持續有一溝通對話及交流之平台。今年的年度大會即將熱鬧登場，我們除進行會務報告外，也將邀請工研院產經中心的專業分析師及長期致力於散熱技術研發應用的專家分別就未來電子產品發展趨勢及散熱產品發展作一精采的專題演講；除此之外，也同步舉辦技術成果發表會，今年將有來自產學研單位 22 篇的研究成果發表，並將選出最佳論文獎。本次技術發表內容包括散熱材料、熱管、均熱板、壓電風扇、LED 散熱、熱量測及熱設計模擬等相關熱管理技術領域，現場亦有多家廠商的產品展覽，內容精采可期，值得大家與會聆聽及瀏覽。台灣熱管理協會在此誠摯邀請所有會員及致力於熱管理相關領域的產學研人士熱烈參與本次年會，增進彼此的交流及互動。

◆指導單位：經濟部技術處
◆主辦單位：台灣熱管理協會(TTMA)
◆協辦單位：工業技術研究院 材料與化工研究所
◆舉辦時間：103 年 4 月 10 日(星期四) 09:30~17:00
◆舉辦地點：臺大醫院國際會議中心 402 會議室
◆舉辦地址：台北市中正區徐州路 2 號　電話：(02)7724-0109
◆敬邀對象：TTMA 會員及對熱管理有興趣之產官學研人士
◆議程內容：

時間	活動內容	主講人
09:00~09:30	報　到	
09:30~09:50	主席致詞及最佳論文獎頒獎 貴賓致詞	蔡柏彬 理事長 (奇鋐科技股份有限公司 採購事業處 處長) 李宗銘 副所長 (工研院 材化所)
09:50~10:10	102 年會務報告及 103 年活動規劃	黃振東 秘書長
10:10~10:30	休　息	

時間	活動內容	主講人
10:30~11:10	智慧行動終端市場與產品趨勢	王英裕 資深專案經理 (工研院產經中心 IEK 電子與系統研究組)
11:10~11:50	防塵與除塵風扇介紹	廖津均 博士 (建準電機工業股份有限公司 冷卻模組事業處 總工程師)
11:50~13:00	午餐及發表場地準備	
	A 場	**B 場**
時 間	題目、發表人	題目、發表人
13:00~13:20	具不同支撐結構之微平板型熱管性能研究 楊愷祥 資深研究員 (工研院 綠能所)	以田口法設計熱流模擬元件模型－以硬碟為例 陳驊 技術主任 (緯創資通股份有限公司)
13:20~13:40	雙層毛細結構於迴路式熱管性能 增強之研究 吳聖俊 教授 (中華科技大學 航空機械系)	在 CFD 的數值分析平台開發被動旋轉風扇 模擬與實驗匹配 張勃緯 副總經理 (信甫科技有限公司)
13:40~14:00	兩相逆流熱虹吸之研製與性能分析 蘇威奇 助理研發師 (核能研究所)	利用熱傳模擬與實驗改善 3D 列印的成型品質 崔春山 經理 (皮托科技股份有限公司)
14:00~14:20	薄型均熱板氣室高度改變影響之研究 陳浦維 兼任助理 (國立台北科技大學)	LED 溫度靈敏係數 TSP 之精確量測方法的研究 蔡雨澂 先生 (國立清華大學 工程與系統科學系)
14:20~14:40	電極型式對集中式熱源散熱之影響 林佳輝 先生 (雲林科技大學)	均溫板一維擴散與二維擴散熱阻之量測理論與實驗 朱品彥 先生 (國立清華大學 工程與系統科學系)
14:40~15:00	高功率模組使用液冷式散熱之研究 陳冠丞 先生 (國立交通大學 機械工程所)	熱電模組發電性能之量測估算方法 簡恆傑 正工程師 (工研院 電光所)
15:00~15:20	休 息	
15:20~15:40	鋼胚加熱爐合理化參數建立 張至中 工程師 (中國鋼鐵股份有限公司)	石墨熱擴散產品的開發、製造及運用 莊孝根 Sr. Technical Director (世譽產品標識有限公司)
15:40~16:00	HFE-7100 微通道熱沉應用於高性能 散熱模組研究 邱顯文 先生 (國立雲林科技大學)	氧化鋁/銅複合基板的界面與導熱 段維新 教授 (國立臺灣大學 材料科學與工程學系)
16:00~16:20	不同型式散熱單元對熱致電模組產電效率 之影響 李進興 副教授 (國立台北科技大學 材料暨資源工程系)	高導熱平面導熱片之配方開發 林勃汎 副研究員 (財團法人紡織產業綜合研究所)
16:20~16:40	雙壓電片致動噴流風扇 邱千瑋 先生 (國立台灣海洋大學 輪機工程學系)	不同散熱基板材料應用於 LED 之熱流照明性能分析 劉冠慶 先生 (國立臺灣海洋大學 輪機工程學系)
16: 40~17:00	毛細泵吸環路在太陽能熱水器的應用 黃筧 先生 (國立清華大學 工程與系統科學系)	
17:00~17:20	散會	散會

※主辦單位得因無法控制情況，調整課別場次之課題與講師。

◆報名資訊：(含講義、午餐與精緻茶點)

1.報名方式：請逕自上網報名

http://www.thermal.org.tw/Events/seminar-form-in.asp?BtfiZ2j=

2.報名與繳費截止日：103 年 3 月 31 日 星期一

※名額 150 人，請從速報名! 依繳費順序額滿為止。

※恕不受理現場報名與繳費，敬請事先完成報名手續為荷。

※報名後不克參加者，請務必於會議前二日以書面或電子郵件告知取消；未告知取消者，視同參加不予退費。

※電匯繳費後請於收據上註明「公司名稱、課程訊息、姓名、聯絡電話」，傳真至(03)5820207 劉小姐收，使用 ATM 轉帳繳費後，煩請將轉出銀行代號 3 碼與帳號後 5 碼 E-mail 至 TTMA@itri.org.tw，謝謝!!

3.報 名 費：

TTMA團體會員：2人免費。增加名額者，每人優待為新台幣$1,000元整

TTMA個人會員：免費(僅限本人)

一般人士：新台幣$2,500元整

學　　生：新台幣$800元整 (不包含在職進修生，請於3月31日前傳真學生證至(03)5820207 劉小姐收，始可享有學生優惠價，以學生身份報名者，恕無法開立公司行號之收據!)

4.繳費方式：

●電匯或ATM轉帳：

收款銀行：臺灣土地銀行 工研院分行

收款帳號：156-001-00163-9 (土銀代碼：005)

收款戶名：台灣熱管理協會

●即期支票：

支票抬頭：台灣熱管理協會

郵寄地址：310 新竹縣竹東鎮中興路4段195號52館709室 劉小姐收

◆報名聯絡專線：劉小姐 (03)5918269　Fax：(03)5820207　E-mail：TTMA@itri.org.tw

◆協會網址：http://www.thermal.org.tw

◆臺大醫院國際會議中心交通及停車資訊

會議中心週邊動線圖

交通

捷運

- 淡水北投線(紅線)：台大醫院站二號出口
- 板南線(藍線)：善導寺站二號出口

公車

- 捷運善導寺站：0 南 / 15 / 22 / 202 / 212 / 212 直達車/ 220 / 232 / 232 副 / 257 / 262 / 265 / 299 / 605 / 671
- 成功中學站(濟南路林森南路口)：265 / 297 / 671
- 開南商工站(近徐州路口)：0 南 / 15 / 22 / 208 / 295 / 297 / 671
- 台大醫院站:22 / 15 / 615 / 227 / 648 / 648 綠 / 中山幹線 / 208 / 208 直達車 / 37 / 坪林-台北 / 烏來-台北
- 仁愛林森路口站（林森南路口）：295 / 297 / 15 / 22 / 671
- 仁愛林森路口站（仁愛路口）：245 / 261 / 37 / 249 / 270 / 263 / 621 / 651 / 630

會議中心停車場動線圖

會議中心備有地下停車場共 135 個停車位，平日收費每小時$40 元，會議來賓停車優惠收費每小時$30 元，年會當天欲離場時請持停車卡至報到處蓋章，即可享有會議來賓停車優惠。